



お客様各位

資料中の「ラピステクノロジー」等名称の ローム株式会社への変更

2024 年4 月1 日をもって、ローム株式会社は、100%子会社である
ラピステクノロジー株式会社を吸収合併しました。従いまして、本資料中にあります
「ラピステクノロジー株式会社」、「ラピステクノ」、「ラピス」といった表記に関しましては、
全て「ローム株式会社」に読み替えて適用するものとさせていただきます。
なお、会社名、会社商標、ロゴ等以外の製品に関する内容については、変更はありません。
以上、ご理解の程よろしくお願いいたします。

2024 年4 月1 日
ローム株式会社

ラピステクノロジー製品の形名の構成

品名の構成



記号の付与

1 デバイス機能

機能により、以下のように区分します。

MD: DRAM

MR: P2ROM™、OTPROM

MS: 画像用メモリ

ML: ロジック

MK: モジュール、チップセット

MT: ドライバ

2 デバイスコード

数字と英文字の組合せで、デバイス固有の機能を表します。

3 キャラクタ記号

既存製品の改良表示、既存製品の標準仕様と異なる仕様の強調、もしくは設計基準を表示する場合に付加される記号です。

4 派生コード

DRAM製品はスピードランク、ロジック製品については派生コードを表します。

5 パッケージ記号

パッケージの種類やリード曲げ形状を2桁で表します。

6 オプション区切り記号

オプションコードとパッケージ記号を区分けする記号です。

7 オプションコード

オプションが付加される製品については、その仕様を識別する記号が入ります。

既存の製品の品名について 従来品については、下記の様になっております。



1 プロセス区分

A: アナログ

C: Bi-CMOS、複数チップ製品

L: バイポーラロジック

M: MOS

2 回路種別

回路種別を表します。

5 パッケージ形状

パッケージ形状を表します。

※パッケージ形状は表記していません。